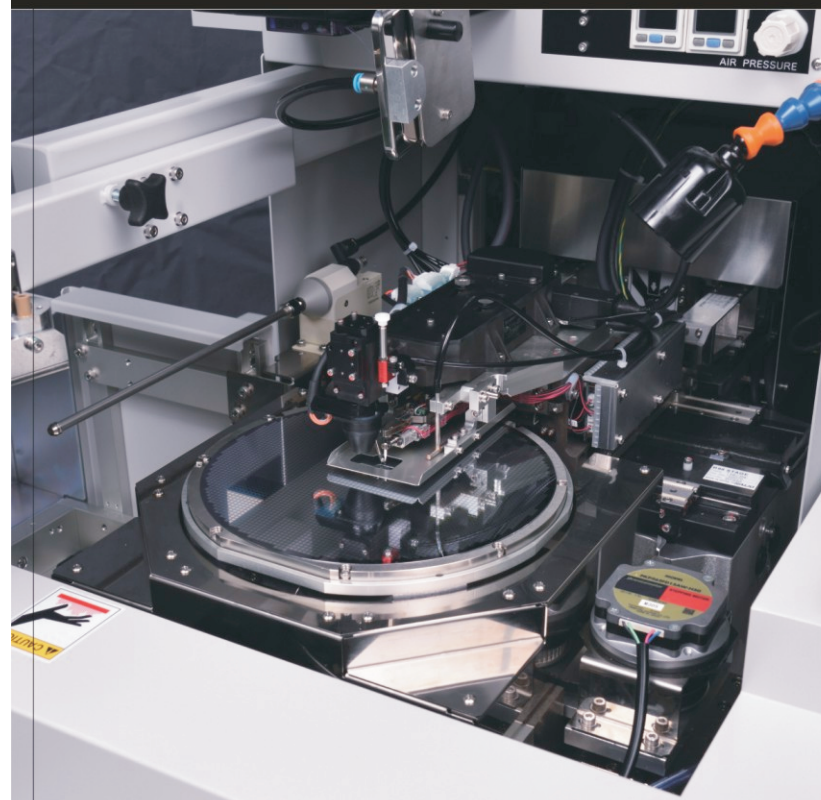


FB-996 BUMP II

Semi-Automatic
8" wafer Stud Bump Bonder

最大可对应 8 英寸晶圆



KAIJO



FB-996 BUMP II 特性

- * 产能提高 12% (较我司旧机种 WBB-700)
 - * 对应 4~8 英寸晶圆 (手动放置)
植球范围 (最大 195mm)
 - * 减小焊线平台热辐射影响的超小型振动子
 - * 配置各种安全对策, Mapping, 追踪管理 (选项)
 - * 控制空气消耗的环保设计
 - * 可对应低温焊接 (50°C 为止的实例)
 - * 优化的重复位置精度 $\pm 3\mu\text{m}$ (3σ)
 - * 后预热部功能可选配安装
- * Productivity 12% up compared to our conventional model.
 - * 4-8" wafer handling capability (Manual loading)
-stud bump area : up to 195mm
 - * Compact transducer, lessen the impact from radiation heat of bonding stage
 - * Various safety measures, Wafer mapping software & traceability capability (option)
 - * Eco design with phenomenally low air consumption
 - * Lowered temperature bonding (Track record: 50 degree C)
 - * Outstanding position repeatability of $\pm 3\mu\text{m}$ (3σ)
 - * Post-Bond-Inspection system is available (option)

FB-996 ^{BUMP} II

8" wafer Stud Bump Bonder

■ 主要规格

| | |
|----------|---|
| 焊线性能 | |
| 重复焊线精度*1 | ±3.0μm (3σ)*2 |
| 焊线范围 | 195mm×195mm*3 |
| 图像识别系统 | 高速、高精度图像处理引擎 1/3"CCD摄像机 2.1倍/6倍镜头 |
| 焊线能力 | |
| 焊线速度 | 30msec/BUMP (Pull-Cut 模式) 40msec/BUMP (Fix-Cut 模式) |
| 图像识别时间 | 100msec/2点 (5mm芯片时) |
| 搬送能力 | |
| 晶圆尺寸 | 最大 8" 晶圆 |
| 搬送方式 | 半自动搬送 (手动放置) |
| 操作性 | |
| 显示器 | 19.5" 彩色显示器 |
| 操作面板 | 附带 3 个按钮鼠标操作 操作面板上专门配备了使用频率高的专用开关 |
| 外部通讯 | |
| | HSMS标准配置 |
| | USB存储器 |
| 应用条件、其他 | |
| 干燥压缩空气 | 0.3~0.97MPa (3.1~9.9Kgf / cm ²) 35N ℓ / min. |
| 真空 | -53.32KPa 以下 (400mm / Hg以上) |
| 供电电压 | AC200V, 50 / 60Hz, ±5%以下 (可选择 AC210V, 220V, 230V, 240V) |
| 最大消耗电力 | 瞬间最大功率 1.5KVA 额定功率 0.8KVA |
| 外观尺寸 | W930×D1237×H1729mm (包括信号灯 H2010mm) |
| 重量 | 550kg |

*1 不包含设备自行调整精度

*2 根据产品有差距

*3 包含晶圆平台 (X 轴驱动、Y 轴驱动、θ 轴旋转) 的移动量

■ SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bonding | |
| Repeatability of Bonding Accuracy *1 | ±3.0μm (3σ)*2 |
| Bonding Area | 195mm×195mm*3 |
| Recognition System | High Speed, High Accuracy Process Engine 1 / 3" CCD Camera 2.1 and 6 magnification lenz |
| Productivity | |
| Bonding Time | 30msec/Bump (Pull-Cut mode) 40msec/Bump (Fix-Cut mode) |
| Recognition Time | 100msec / 2 points (5mm square Chip) |
| Indexing System | |
| Wafer Size | Maximum 8" wafer |
| Wafer Handling | Semi-Automatic (Manual wafer loading) |
| Operability | |
| Monitor | 19.5" color Wide LCD |
| Operation Panel | Operation by mouse with 3 buttons Frequently used switches in console |
| External Interface | |
| | HSMS |
| | USB memory |
| Utility | |
| Air | 0.3~0.97MPa (3.1~9.9Kgf / cm ²) 35N ℓ / min. |
| Vacuum | -53.32KPa 以下 (400mm / Hg or more) |
| Power Source | AC200V, 50 / 60Hz, ±5%以下 (AC210V, 220V, 230V, 240V option) |
| Power Consumption | Peak 1.5KVA Sequential Operation 0.8KVA |
| Overall Dimensions | W930×D1237×H1729mm (Incl. signal tower: 2010mm) |
| Weight | 530kg |

*1 Excluding Self-Teach Accuracy

*2 The value differs depending on devices.

*3 The value includes movement of wafer stage (X axis drive, Y axis drive, Theta axis rotation)

⚠ 注意事项: 为了安全使用商品, 使用前请仔细阅读操作说明书。

● 目录上的注意... 目录上所刊载商品的规格以及外观如有所改良恕不另行通知, 请知悉。

⚠ CAUTION FOR SAFE: Please read surely INSTRUCTION MANUAL before operate.

● Specification is subject to change without prior notice for improvement.



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION URL <https://www.kaijo.co.jp>
東京都羽村市栄町 3-1-5 〒 205-8607 TEL 042-555-2244



深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Hanhwa Semiconductor Technology Co., Limited

地址: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋
电话: 0755-8524 0596 传真: 0755-2300 1062
邮箱: chenyp@hanhwachina.cn
网站: www.hanhwachina.cn

